证券简称: 东山精密

苏州东山精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号: 2025-08-27

投资者关系活动 类别	□ 特定对象调研	□ 分析师会议
	□ 媒体采访	□ 业绩说明会
	□ 新闻发布会	□ 路演活动
	□ 现场参观	
	☑ 其他 (2025 年半年报业绩说明会)	
参与单位名称及 人员姓名	国盛、华泰、国信、申万、招商、花旗等 298 位投资者	
时间	2025年8月27日上午10:00-11:00	
地点	进门财经电话会议	
上市公司接待人 员姓名	执行总裁 单建斌	
	董事会秘书 冒小燕	
	投关总监 熊丹	
投资者关系活动主要内容介绍		
	1. 关于公司 PCB 业务中 M	ultek 新增 10 亿美元投资的规划,目前
	珠海和泰国的投资进展如何?后续的产能产值展望是怎样的?	
	答: (1) 公司为 Multek	制定了10亿美元的整体投资规划,投
) 资进程预计持续 2-3 年。	目前已投入约2亿美元用于现有基地的
	 高层高速线路板相关设备	升级,该部分新增产能计划于明年上半
	 年逐步释放。(2)泰国	方面, 硬板当前约有1亿美元的投资正
	 在推进,部分生产设备已	进入落地安装与调试阶段,项目按计划
	有序开展。	
	11/1 /1///	
	o 建闭IED UP L业ケ山	·) 工版的居田且从7.0 心机 - 日經過)
		入下降的原因是什么?此外,尽管收入
	下滑,但毛利同比有所提 	升,请问具体原因是什么?同时,能否
	介绍一下 LED 业务今年全	年的盈利展望、降本增效的进展以及新

客户开拓的情况?

答: LED 业务上半年收入下滑,主要受行业整体需求不振影响,下游领域投资开支缩减,叠加行业产能与当前市场需求存在一定差距,导致承压。而毛利率同比提升,一方面是本期折旧成本有所减少,降低了成本端压力;另一方面是公司持续推进 LED 业务结构性调整。未来公司整体战略将更聚焦发展前景较好的业务方向,同时会持续深化 LED 业务的降本增效工作与新客户开拓进程。

3. 公司于 6 月中旬发布公告收购索尔思光电,请问这一举措是基于未来怎样的战略布局?目前索尔思的进展情况如何?索尔思与现有 PCB 业务在协同性方面有哪些具体分享?

答:自去年下半年起,公司开始规划 2025 年后的发展方向。此前"消费电子+新能源"双轮驱动战略已完成阶段性任务。基于对"下一个时代是人工智能(AI)时代"的判断,公司聚焦产业链具备比较优势的 AI 高速互联与传输领域(含高速 PCB、光通信等)。今年6月公告收购索尔思光电,推进 AI 战略下光互联领域的布局与扩展,目前项目推进顺利。

4. 关于本次 PCB 业务 10 亿美元的投资,是主要基于我们对 AIPCB 产业趋势的看好,还是已经有客户给出了未来两年的订单预期? 如果有客户的话,主要是哪些客户,订单集中在哪些方向? 答:本次 PCB 业务投资决策,源于管理层自去年下半年形成的共识,核心基于两大维度:一方面,公司在软板和硬板领域整体稳居全球前三,但硬板业务中,除 HDI (高密度互联板)外的其他品类产能相对薄弱,此次投资旨在补足这一短板;另一方面,高速互联、超高难度产品存在市场需求。

5. Multek 之前接触的客户类型中,是否已经包含北美客户?公

司在硬板方面的技术积累如何?

答: Multek 产能布局聚焦多核心赛道,涵盖 HDI(高密度互联板)、快速高度层板等关键领域,产品矩阵可匹配多元化应用需求,累计服务企业超 300 家,且以国际客户为主体,覆盖云服务厂商、交换机制造商、服务器生产商等海外主流行业领域,在北美市场已沉淀成熟且稳定的客户资源。从技术与生产能力来看,公司具备全面的 PCB 产品生产能力,可覆盖高难度产品领域,其中在硬板技术层面,通过长期研发与实践积累,已形成较强的综合竞争力,能够满足高端硬板产品的生产需求。

6. 关于 Multek10 亿美金投资规划,目前是以海外设备厂商为主还是考虑采用国内设备?是否存在因设备紧缺而调整策略的情况?

答: 当前一期设备投资仍以海外厂商为主,相关合作已完成沟通,进展正常;二期投资预计将采取"海外+国内"设备互补策略。鉴于国内设备厂商技术迭代加快,在部分新技术领域已具备技术先进性与成本优势,公司正同步评估国内外设备方案,以实现资源最优配置。截至目前,未出现因设备紧缺需调整投资策略的情况,设备采购与项目推进节奏可控。

7. 对于高速互联的超高难度板,关键的技术是什么? 东山精密是如何获得这些技术的,是否有量产经验?

答:高速互联超高难度板的关键技术主要有两点:一是高多层板在高速传输中的信号完整性控制,这是高速板的核心基础要求; 二是板与板之间的特殊互联技术,该技术在通信领域已具备量产经验。公司在 PCB 领域有着长期的技术积累;目前已具备相关技术的实际量产经验,可顺利完成高难度板件的打样与生产。

8. 软板在公司中的定位和发展方向是什么?

	答: 软板目前仍是公司"压舱石"级别的核心业务。近年来受消
	费电子终端产品增长趋缓影响,软板相关资本开支进程较此前有
	所放缓。公司对软板资本开支采取"攻守结合"的策略,在必要
	环节优先保障资金投入,以维持软板业务基本盘的稳定运营。
	9. 目前在 AR 眼镜以及其他产品线上,软板业务有哪些新的开拓
	或进展?
	答: 在 AR 眼镜领域,公司与国外主要厂商保持良好合作关系,
	同时已参与国内知名 AR 眼镜品牌的量产项目。
附件清单(如有)	无
日期	2025-08-27